



efus™, der neue COM Formfaktor von F&S Kompakter, preiswerter und extrem flexibler Formfaktor für Cortex-A CPUs

easy	Starterkit, Workshop, angepasstes WEC 2013/ Linux, kostenfreier Support
functional	Viele Schnittstellen, erweiterbar mit Funkmodulen, einfaches Basisboard
universal	für Anzeigen – Kommunikation - Bedienung (in Industrie- und Medizintechnik)
small	Größe nur 47 x 62mm, 5V Versorgung

Auf der Embedded World 2014 wurden erste Muster dieses neuen COM Formfaktors vorgestellt. Nun stehen Starterkits mit angepasstem WEC 2013 und Linux zur Verfügung.

Der neue Formfaktor von F&S Elektronik Systeme in Stuttgart, die efus™ Produktfamilie, verwendet den von Q7 Boards bekannten gängigen 230 Pin MXM-2 edge connector. Die Pinbelegung dieses Steckverbinders wurde so clever gewählt, dass sich auf dem Basisboard keine Signalleitungen zu den Steckverbindern kreuzen und eine 4-Lagen- Leiterplatte ausreicht (EasyLayout). Für die Hardware-Entwicklung stehen die Layoutdaten für EAGLE kostenfrei zur Verfügung.

Zur mechanischen Befestigung der efus™ auf dem Basisboard wird der Verriegelungsmechanismus, EasyMount verwendet.

Für Kunden die weitere Funktionen auf dem Modul benötigen, kann die efus™ durch ein einfaches, kostengünstiges und risikofreies ReDesign erweitert werden. Schon verfügbare Erweiterungen sind WLAN/ Bluetooth (mit Chipantenne oder Buchse), ZigBee, Z-Wave oder auch EnOcean.

Mit der F&S- Projektgarantie begleiten wir unsere Kunden vom Projektstart bis zum erfolgreichen Abschluss des Projektes. Dafür stehen Starterkit und Workshop, Unterlagen für Hardware- und Software Entwicklung und kostenfreier Support zur Verfügung.

Das erste Modul dieser neuen Produktfamilie, die efus™A9, ist mit einer Freescale i.MX6 Cortex-A9 CPU ausgerüstet. Für Multimediaanwendung bietet diese mächtige CPU 3D Grafik (100MTri/s, 1000Mpx/s), Hardware Decoder/Encoder mit einer Auflösung bis zu 1080p, H.264 HP, HDMI v1.4. , ARMv7™, NEON und VFPv3. Weitere wichtige Eigenschaften sind die Langzeitverfügbarkeit von bis zu 15 Jahren und der verfügbare Temperaturbereich von -40°C bis +85°C. Auf der efus™A9 stehen bis zu 1GByte RAM und 32GByte Flash und Schnittstellen wie Gigabit-Ethernet, USB Host, USB Device, 2x CAN, 2x I2C, 2x SPI, 4x Serielle, GPIOs, 2x uSD-Card, I2S, SATA, PCIe und Kamera zur Verfügung.

Zum Displayanschluss werden digital RGB, 2-Kanal LVDS (bis FullHD, JILI30 kompatibel) und DVI gleichzeitig angeboten. Über die I²C Schnittstelle kann sowohl ein resistiver 4-Draht- als auch ein kapazitiver Touchcontroller angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über 5V, die Leistungsaufnahme der Single-Core Version liegt bei 1.5W (typ.). Für die efus™A9 werden Linux, WEC 2013 wie auch WEC 7 angeboten.

Ein weiteres besonderes Merkmal ist der günstige Preis ab Euro 39,- (je nach Ausstattung und Stückzahl, exklusive MwSt).

Weitere Module im efus™ Formfaktor folgen im Laufe des Jahres 2014 (mit Cortex-A5 ab Ende 2014). Zu beziehen ist die efus™A9 direkt bei F&S Elektronik oder über einen der europaweiten Distributionspartner.

Weitere Informationen unter www.fs-net.de.

Dipl. Ing. (FH) Karlheinz Kusch
Vertriebsleiter F&S Elektronik Systeme GmbH
Untere Waldplätze 23
70 569 Stuttgart
Tel: +49 (0711) 123722-29
Fax: +49 (0711) 123722-99
kusch@fs-net.de